

株主様向け
アンケート

株主のみなさまの声を お聞かせください

当社では、株主のみなさまの声を聞かせいただくため、アンケートを実施いたします。お手数ではございますが、アンケートへのご協力をお願いいたします。

下記URLにアクセスいただき、
アクセスコード入力後に表示される
アンケートサイトにてご回答ください。
所要時間は5分程度です。

 <http://www.e-kabunushi.com>
アクセスコード 4975

いいかぶ

検索

Yahoo!、MSN、exciteのサイト
内にある検索窓に、いいかぶと
4文字入れて検索してください。



空メールによりURL自動返信

kabu@wjm.jpへ空メールを送信してください。(タイトル、本文は無記入)
アンケート回答用のURLが直ちに自動返信されます。



携帯電話からもアクセスできます

QRコード読み取り機能のついた携帯電話をお使い
の方は、右のQRコードからもアクセスできます。



●アンケート実施期間は、本書がお手元に
到着してから約2ヶ月間です。

ご回答いただいた方の中から
抽選で薄謝(図書カード500円)
を進呈させていただきます



※本アンケートは、株式会社エーツーメディアの提供する「e-株主リサーチ」
サービスにより実施いたします。(株式会社エーツーメディアについての詳細
<http://www.a2media.co.jp>) ※ご回答内容は統計資料としてのみ使用させ
ていただき、事前の承諾なしにこれ以外の目的に使用することはありません。

●アンケートのお問い合わせ TEL: 03-5777-3900(平日 10:00～17:30)
「e-株主リサーチ事務局」 MAIL: info@e-kabunushi.com



株主メモ

事業年度 毎年4月1日～翌年3月31日
剰余金の配当基準日 期末配当 3月31日
中間配当 9月30日

定時株主総会 毎年6月下旬
単元株式数 100株
株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社

	証券会社に口座を お持ちの場合	特別口座の場合
郵便物 送付先		〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4
電話お問い 合わせ先	お取引の証券会社になり ます。	0120-288-324 (フリーダイヤル)
お取扱店		みずほ信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 みずほインベスターズ 証券株式会社 本店及び全国各支店
ご注意	未払配当金の支払※、支 払明細発行については、 右の「特別口座の場合」 の郵便物送付先・電話お 問い合わせ先・お取扱店 をご利用ください。	単元未満の買取・買増以 外の株式売買はできません。 電子化前に名義書換を失 念してお手元に他人名義 の株券がある場合は至急 ご連絡ください。

※未払配当金のみ、株式会社みずほ銀行 全国本支店でもお取扱いいた
します。

公 告 方 法 電子公告 (<http://www.jcu-i.com/>)

ただし、やむを得ない事由によって、電子公告による公告をするこ
とができない場合には、日本経済新聞に掲載して行います。



荏原ユーザライト株式会社

〒110-0016 東京都台東区台東4-19-9 山口ビル7
TEL: 03-3833-0321 FAX: 03-3833-5075
<http://www.jcu-i.com/>



株主・投資家のみなさまへ

第51期 年次報告書 2010.4.1—2011.3.31

JCU (荏原ユーザライト株式会社)

証券コード: 4975



東日本大震災のお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興を衷心よりお祈り申し上げます。

株主・投資家のみなさまの中にも直接・間接被害にお遭いになった方々がたくさんいらっしゃるのではないかと懸念しております。しかし、歲月人を待たずの諺の通り、平成23年3月末の決算日がやってきました。3月11日の東日本大震災の影響で予定して

おりました経営目標のうち、売上高だけが100%達成することはできませんでしたが、当社としては国内外で精いっぱいの結果を出すことができたと自負しております。

当社の当期決算は売上高122億3千2百万円、営業利益15億1千7百万円、経常利益14億8千5百万円、当期純利益8億5千4百万円となりました。

当期の特筆すべき事項は、タブレット端末、スマートフォンなどの売上の好調さに支えられたものであります。特にエニーレイヤー工法への転換によるビアフィリング用薬品の売上高増加が国内外を通じ、当期間中続いたことによるものであります。この傾向は来期も引き続き継続するものと確信しております。何故ならば、当期間中に台湾、韓国大手メーカーが相次いでめっき装置を増設し、本年7月以降本格稼働するものと確信しているからです。

また、配当につきましては、上半期27円、下半期30円の計57円とさせていただきたく、すでに2月4日付にて発表させていただいております。来期は上半期30円、下半期30円、計60円の配当を予定しておりますが、経営状況が予算通り推移する場合は、更に増配を検討したいと考えております。

1 国内の状況

大震災が起るまで、日本の自動車生産は比較的好調に推移いたしました。米国経済の持ち直し気分と中国、韓国などの自動車生産の好調さに支えられたものであります。また、上半期はエコカー減税など政府の支援策が有効に機能したのと考えております。

しかし、3月11日の大震災以降日本の自動車生産は部品不足のため操業停止の状態に追い込まれており、5月上旬になっても100%フル稼働できる状態にはなっていないのが現状です。この部品不足の影響は中国、韓国はもとより、米国にも波及していると聞いております。正常化するには第1四半期いっぱいかかるものと覚悟しております。

一方、プリント配線板業界は新しいスマートフォンタイプ携帯端末の好調な売れ行きに支えられて、比較的好調に推移してまいりました。しかし、大震災による影響は大きく、原材料不足に悩まされたのです。この震災の被害に遭った会社の中には、日本での再建を諦め、海外に拠点を移す工場もあると聞いております。来期の見通しを考えると、頭の痛い問題でもあります。

2 海外の状況

海外の自動車関連産業は中国を筆頭に、韓国、タイなど前期に引き続き順調に推移いたしました。中国での自動車生産は900万台から1,000万台へと大きく躍進しており、めっき装置への設備投資も活発でした。この傾向は来期も引き続き継続するものと予想しております。また、タイ、インドネシアへの設備投資を見逃すことはできません。当社もインドネシアに現地法人を設立する準備を始めております。インド、ブラジルへは昨年秋に各々調査団を派遣いたしました。現地法人設立には2～3年様子を見ることが得策との結論になりました。いずれにしてもインド、ブラジルへの進出は近い将来決断しなければならない課題ですが、日本の自動車メーカーの市場占有率が8～10%ぐらいにならないと、現地法人を作っても機能しないのではないかと考えています。その点、インドネシアの自動車

や二輪車の市場占有率は90%を超えているので年内にも現地法人設立とその第一歩を踏み出したいのです。

一方、プリント配線板や半導体の海外状況はタブレット端末、スマートフォンタイプ携帯端末や家電製品の好調さに支えられて順調に推移しておりました。この傾向は大震災の影響を多少受けたとは思いますが、現在もお好調です。特にタブレット端末、スマートフォンタイプ携帯端末のエニーレイヤー工法の採用によって、ビアフィリング用薬品は日本はもとより、韓国、台湾でスマートフォン向けにおいてほぼ独占的シェアを維持しております。当社としては更に新規開発製品、VL、VH、VF5の製品を市場に投入し、他社の追従を許さない強さを更に発揮させたいと考えております。より薄くより平坦なスルーホールめっきができる薬品を提供してまいります。

また、半導体TSV用銅めっきプロセスの開発にも成功しており、世界の注目を浴びております。

3 来期の戦略

東日本大震災の影響で原発に対する国民感情は一気に反原発へと進んでいるように思います。また、東電の福島第一原発だけでなく、中電の浜岡原発まですべて停止に追い込まれることになると日本の全域で電力不足による色々な影響が出てくることは否めないことでしょう。

その点から国内から海外重視に視点を移し、新たな戦略を模索しなければならないと考えております。当期に現地生産体制の確立を行いました。来期は研究部門の現地化に注力し、よりよい人材の確保と現地のニーズに合った製品の開発を促進したいと考えております。各国の大学や研究機関との連携を一層増進したいと考えて、すでに研究所のメンバーを各国の現地法人に outward させることにいたしました。これで各現地法人も管理部門、営業部門、生産部門、研究開発部門と顧客技術サービス部門を持つことになり、本当の意味の会社としての確立ができることとなります。

次に重点戦略アイテムをご紹介します。

① 太陽光発電事業

太陽光発電設備のカバーガラスのコーティング事業とシステム設備の販売と設置事業の本格的展開です。原発事故を受

けて、電力不足と自然エネルギーへの関心が高まるなか、当社はよきパートナーに恵まれて、太陽光発電事業を発展拡大するチャンスに恵まれました。

また、蓄電設備の導入や設置にも取り組む予定です。来期は太陽光発電関連の大型投資が必要になるものと考えております。ご期待ください。

② ボルト・ナットコーティング事業

自動車用ボルト・ナットのコーティング事業が自動車大手の認定も取れ、6月以降大量生産に踏み切ることが決まりました。この技術は、従来のボルト・ナットより錆びにくく、コストダウンができますので、世界展開すれば大きなビジネスになると考えております。その他に、完全クロムフリーのボルト、ナットのコーティング事業の開発にも一応の目途がたったことをご報告申し上げます。

③ プラズマ装置事業

プラズマ装置の拡販体制が整い、日本、韓国、台湾の大手メーカーに相次いで採用されるようになりました。これから携帯端末やパソコンなど微細配線基板や液晶デバイスの製造工程まで一層採用されていくものと信じて止みません。すでに数十基の受注をしております。

④ 貴金属めっき事業

貴金属めっきへの新たな展開を計画しております。本件については、次回上半期の株主・投資家のみなさまへのご報告の中で詳細をご説明したいと思います。

⑤ 化粧品事業

化粧品事業への参入については、年内いっぱい準備にかかるかと思いますが、着実に前進しておりますので、ご安心ください。テーマは「美容と健康」です。すばらしい商品ができますので、ご期待ください。

最後に、株主・投資家のみなさまへ当社の経営戦略の基本はあくまで日本を中心とした世界展開を進めることですので、ご理解とご支援をお願い申し上げます。また、来期の事業戦略はどれ一つとっても非常に大きな事業であり、「夢」「希望」「勇氣」を旗印に社員一同一生懸命努力してまいりますので、なお一層のご協力をお願いする次第です。

2011年6月 代表取締役会長兼CEO

粉谷佳允

スマートフォンの普及が追い風となる

多機能端末とは

2007年、日本では「おサイフケータイ」や「ワンセグ」機能搭載の携帯電話開発に力を入れていた頃、海の向こうでは使い勝手がパソコンに近い「スマートフォン」と呼ばれる多機能端末の開発が進められていました。発売以来、日本でもメーカー各社が競って販売を始めており、若者を中心に人気が高まっています。更に、2010年4月に発売された「タブレットPC」と称される多機能端末においては、更に多機能化が図られ話題となっています。これらのモバイル多機能端末は、ネット検索はもとより、電子書籍やカーナビゲーション、ポータブルゲームやモバイルカメラ、ネットテレビなど多目的に使用され、今後も新たな使用方法が提案されていくものと予想されます。

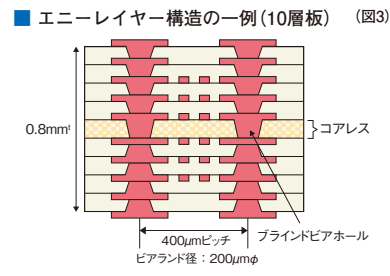
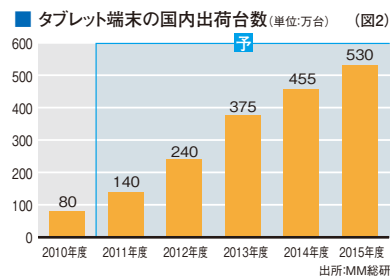
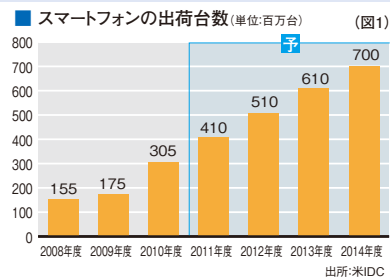
多機能端末の普及拡大

このように携帯電話やノートパソコンに替わり、近年スマートフォンやタブレットPCなどの多機能端末の普及が拡大しています（図1 スマートフォンの出荷台数）（図2 タブレット端末の国内出荷台数）。特に、2010年度のスマートフォン出荷台数は約3億台、2011年度には4億台を超える見通しであり、そこで使用されるプリント配線板の需要も大幅な増加が期待されます。

エニーレイヤー構造のビルドアップ配線板の普及

スマートフォンをはじめとした多機能端末の普及によって、これまで一般的であったスタック構造を用いたビルドアップ配線板に代わり、より薄型軽量で高密度化が可能なエニーレイヤー構造のビルドアップ配線板の採用が拡大していくと思われます。このエニーレイヤー構造では、これまでスタック構造で用いていたコア材を必要としません。これにより配線設計の自由度向上のほか、電気特性や放熱特性の向上も可能となります（図3 エニーレイヤー構造の一例（10層板））。

総合研究所 海外技術統括部長（工学博士）萩原秀樹



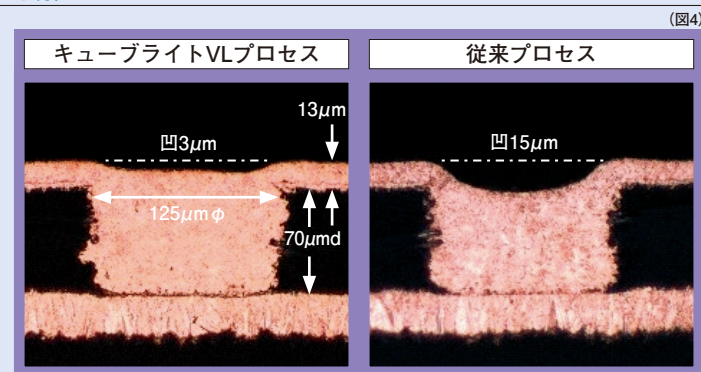
エニーレイヤー構造対応ビアフィリング用銅めっき薬品

当社は、これまでも携帯電話用のHDI基板やパソコン用のMPU向けにビアフィリング用銅めっき薬品を手がけています。ここ1～2年はエニーレイヤー構造のビルドアップ配線板向けの売り上げが拡大しており、また同時に更なる性能アップへの要求も高まってきています。このような背景から、今年は新たに3つのタイプのビアフィリング用銅めっきプロセスを発売します。

- ・キューブライトVL（以下VL）
- ・キューブライトVH（以下VH）
- ・キューブライトVF5（以下VF5）

それぞれ用途が異なるため、簡単にその特長を説明します。VLは、先に説明したエニーレイヤー専用のプロセスです。この特長は、大きいサイズのビアホールに対し従来（例えば25μm）よりも薄い膜厚（例えば15μm）でフィリングできる点にあります（図4）。これにより、従来のプロセスと比較して「微細な回路形成」と「コストダウン」が可能となります。主にスマートフォンやタブレットPC向けエニーレイヤー基板への適応を予定しています。VHの特長は、基板に貫通したスルーホールへの均一な析出と、貫通のしていないビアホールへのフィリング析出の両性能が得られる点にあります。昨今スマートフォンのシェア拡大が報道されていますが、依然ボリュームゾーンとなっている携帯電話やゲーム用基板への適応を予定しています。更に、VF5は次世代のMPU及びGPUパッケージ基板向けのプロセスです。半導体のゲート幅が年々シュリンクしていく（60→45→32→2Xnm）ことに伴い、それらが実装されるパッケージ基板での配線幅（L/S～10μm/10μm）やビアホールサイズ（～φ60μm/30μmd）もシュリンクしてます。VF5は、このような超微細配線基板に対し「均一な析出性」と「10μm以下という極めて薄い膜厚でもフィリングができる」性能を兼ね備えています。

今後、ますます多様化の進む基板設計ニーズに対し、我々は日々の研究によって開発された新プロセスにて対応していく所存です。



太陽光発電事業に関して

3月11日に発生しました東日本大震災で被災されたみなさまに謹んでお見舞い申し上げますとともに、被災地の日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

今回の地震の影響により東日本で当面電力不足が慢性化すると思われ、その緊急対策として地域ごとの大規模な計画停電が実施されております。更に今後夏場での電力不足により深刻な状況になることが予測されます。

また、今回の原発事故により、世界的に原子力発電の見直しが叫ばれており、その反面太陽光発電、水力発電のように自然界から得られる電力については、今後かなり前向きな事業形態となることが予測されます。

当社におきましても太陽光発電設備の設置事業を行っておりますが、このような環境下で、太陽光発電設備により商用



太陽光パネル (200kW)



パワーコンディショナ



太陽光パネル (80kW)

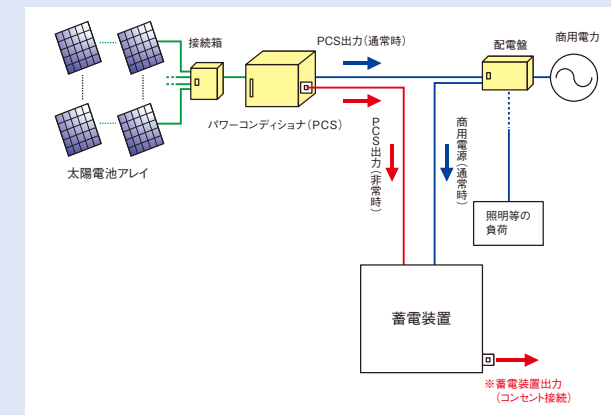
電力からの買電量の削減と、計画停電時における電源の供給ができれば、各方面におきまして、大いにお役に立つことができると考えております。

また、太陽光発電は、日照に左右される等不安定なことが欠点となっておりますが、当社におきましては、下記のような新たなシステムの構築を行い、この状況にいち早く対応してまいります。

1. 停電時は、パワーコンディショナを系統連系から自立運転に切り替えることができるようにして非常用電源として供給できるようにします。
2. 蓄電池設備と太陽光発電設備とをセットとし、電源を安定させるとともに、夜間の使用もできるようにします。これらにより太陽光発電設備の機能を向上させ、積極的に事業を推進してまいりますので、よろしくお願いいたします。



太陽光パネル (50kW)



蓄電装置付太陽光発電システム



表示装置

新事業営業推進本部 木村隆男本部長が紹介した ボルト・ナット上のナノセラミックコーティングプロセス

用途及び要求性能

ボルト・ナットは締結部品の代表的なものであり、私たちの日常生活用品には必要不可欠なものでもあります。代表的な使用例としては以下のようなものがあげられます。

自動車用部品

- 車体外装用締結部品
エンジン
ギアボックス、ブレーキ
- 車体内装用締結部品
内装品類
(キャビネット、シート、パネル他)
電装部品
(エアコン部品他)



家電用部品

建築材料用部品

また、ボルト・ナットは、本来の要求性能である締結性のほかに、現在では、高級感のある外観、識色や組立て時の識別性など、別の性能も要求されています。更に、有害物質を使用しない環境にやさしい処理工程も要求されています。

開発経緯

従来の黒色のボルト・ナット表面処理は3価クロメートの黒色タイプが使われておりますが、以下の欠点が指摘されております。

- ① 安定した耐食性が得られにくい
- ② 外観、色調にバラツキが出やすい
- ③ 任意に摩擦係数の調整ができない（別工程での処理が必要）

このような欠点を解決するため、当社はナノセラミックコーティングプロセスを開発しました。新しいプロセスはシリカをベースとしたコート剤で、2～3μmの薄膜においても優美な外観や黒色の色調が出せ、皮膜に摩擦係数などの機能特性を持たすことのできる従来にな

いコーティングプロセスです。

外観及び色調



プロセスの特長

- ① 外 観 色 調：つやがあり、商品価値の高い黒色外観及び均一で透明な皮膜が得られる。
- ② 締 結 特 性：薬品中のワックス成分の調整により、任意の摩擦係数の調整ができる。
- ③ 高 耐 食 性：白錆発生及び赤錆の発生時間を大幅に延長できる。
- ④ コスト削減：専用の化成処理を行うことで、仕上げ処理やトルカー処理を省略することにより、コスト削減が可能である。

進捗状況

この新しい事業につきましては、以前より株主のみなさまにはご報告いたしておりましたが、いよいよ今年の上半期には量産体制となることがほぼ確実となってきました。現段階では主に自動車用のボルト・ナットに採用されておりますが、今後更に車両以外の建築用ハウスネジや家電用ネジ等の締結部品につきましてクロムフリーを目指し、より環境にやさしいプロセスをご紹介していきたいと思っておりますのでどうぞご期待ください。

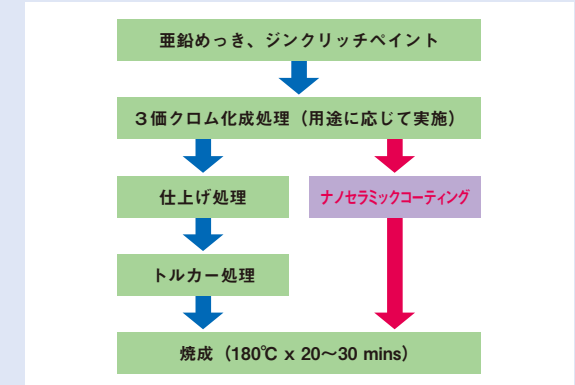


ボルト（側面視）



ボルト（鳥視写真）

工程及び処理条件

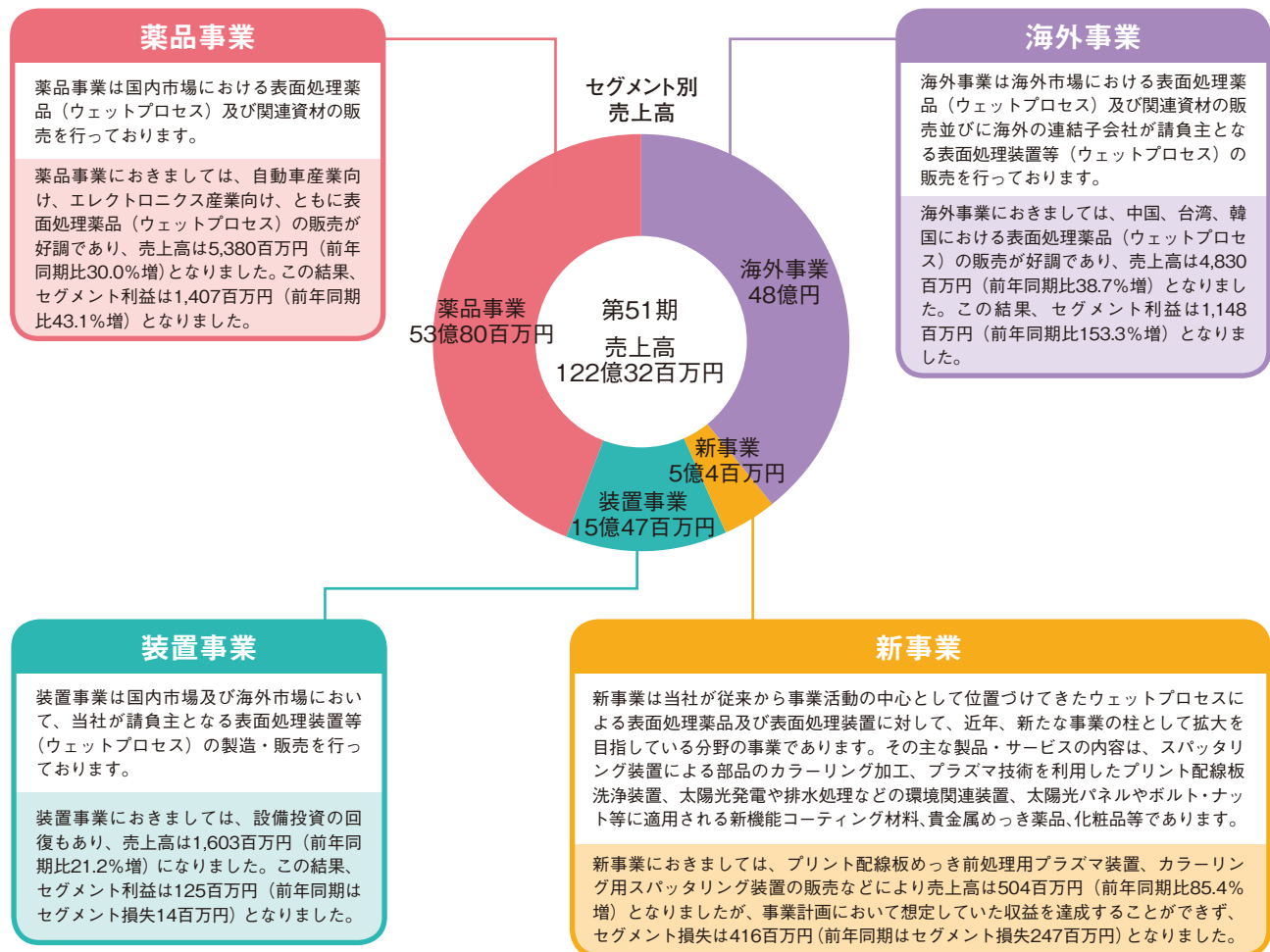


コーティング装置全体写真

セグメント別業績概況

Segment Information

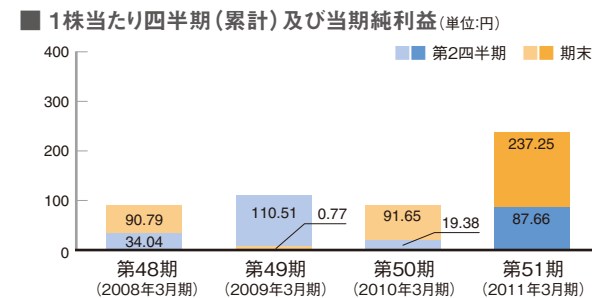
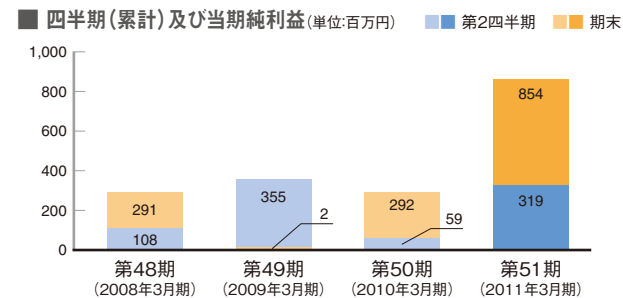
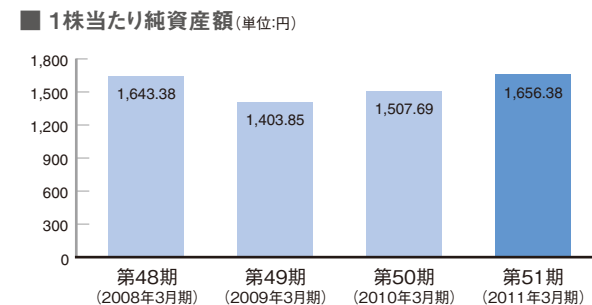
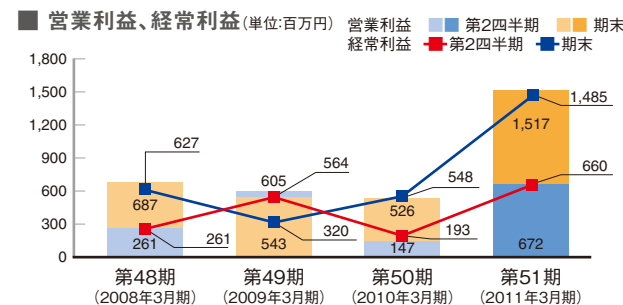
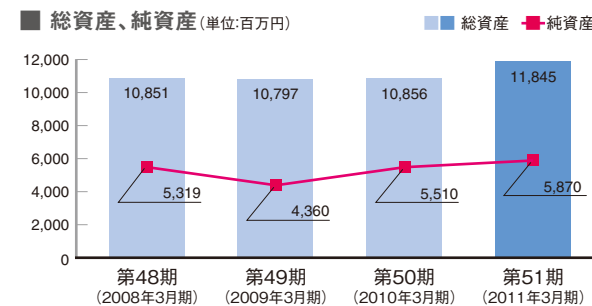
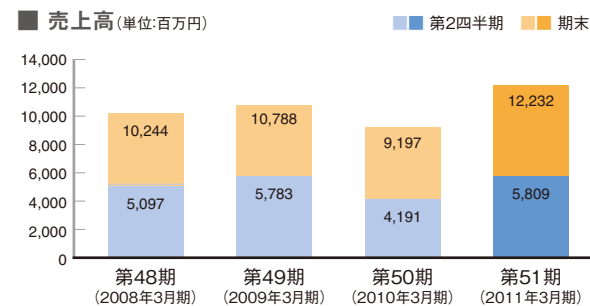
当期より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日）を適用することによって、当社のセグメントの構成単位が下記のように変更となりました。



上記の円グラフにある各事業の構成比は内部取引相殺後の比率であります。

財務ハイライト(連結)

Financial Highlights



連結財務諸表（要旨）

Consolidated Financial Statements

連結貸借対照表

区分	当期末 2011年3月31日現在	前期末 2010年3月31日現在
【資産の部】		
流動資産	7,063,591	6,137,616
現金及び預金	2,498,558	2,071,624
受取手形及び売掛金	3,178,243	2,843,309
商品及び製品	543,092	483,492
仕掛品	90,506	93,299
原材料及び貯蔵品	296,399	207,024
繰延税金資産	232,268	175,987
その他	245,291	290,835
貸倒引当金	△ 20,769	△ 27,956
固定資産	4,782,399	4,718,834
有形固定資産	2,927,241	2,813,310
無形固定資産	351,661	416,425
投資その他の資産	1,503,496	1,489,097
資産合計	11,845,990	10,856,450

(単位:千円)

区分	当期末 2011年3月31日現在	前期末 2010年3月31日現在
【負債の部】		
流動負債	3,861,644	3,538,957
支払手形及び買掛金	1,887,095	1,742,731
短期借入金	99,409	551,205
一年内返済予定長期借入金	747,972	548,004
リース債務	13,480	12,572
未払法人税等	355,773	138,031
賞与引当金	253,931	179,410
前受金	14,633	14,490
繰延税金負債	1,094	—
その他	488,254	352,512
固定負債	2,113,526	1,807,118
長期借入金	1,136,374	1,017,658
リース債務	165,322	179,612
退職給付引当金	557,434	502,208
資産除去債務	161,568	—
その他	92,826	107,639
負債合計	5,975,171	5,346,076
【純資産の部】		
株主資本	6,302,208	5,822,269
資本金	1,176,255	1,176,255
資本剰余金	1,128,904	1,128,904
利益剰余金	3,997,241	3,517,191
自己株式	△ 191	△ 81
その他の包括利益累計額	△ 459,692	△ 332,973
その他有価証券評価差額金	△ 81,381	△ 82,001
為替換算調整勘定	△ 378,311	△ 250,971
少数株主持分	28,303	21,077
純資産合計	5,870,819	5,510,374
負債純資産合計	11,845,990	10,856,450

連結損益計算書

(単位:千円)

区分	当期 (自 2010年4月 1日 至 2011年3月31日)	前期 (自 2009年4月 1日 至 2010年3月31日)
売上高	12,232,869	9,197,729
売上総利益	6,120,600	4,181,003
販売費及び一般管理費	4,603,165	3,654,356
営業利益	1,517,435	526,647
経常利益	1,485,298	548,025
税金等調整前当期純利益	1,333,966	443,300
当期純利益	854,420	292,958

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

区分	当期 (自 2010年4月 1日 至 2011年3月31日)	前期 (自 2009年4月 1日 至 2010年3月31日)
営業活動による キャッシュ・フロー	1,474,802	128,124
投資活動による キャッシュ・フロー	△ 608,462	△ 986,272
財務活動による キャッシュ・フロー	△ 499,922	148,119
現金及び現金同等物 に係る換算差額	△ 32,570	21,445
現金及び現金同等物 の増減額	333,847	△ 688,583
現金及び現金同等物 の期首残高	1,808,164	2,496,748
現金及び現金同等物 の期末残高	2,142,011	1,808,164

株主還元について

利益配分に関する基本方針

当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために適正な自己資本比率を維持しつつ、業績の状況に応じて配当性向等を勘案し、安定した配当を実施することを基本方針としております。内部留保資金の用途につきましては、今後の事業活動並びに経営基盤の強化に有効活用していく方針であります。

		第48期	第49期	第50期	第51期	第52期 (予定)
配当金 (円)	中間	30	30	27	27	30
	期末	30	27	27	30	30

株主優待品ご送付方法変更のご案内

株主のみなさまへの「優待品」のご送付方法につきまして、これまで株主総会終了後、お選びいただけるギフトカタログを「決議ご通知」「年次報告書」などと一緒に送りいたしておりましたが、本年度より、更に中身が充実された厚みのあるカタログに変更されましたため、株主総会の翌日に別送させていただきたくご案内申し上げます。

なお、当社の株主優待品は3月31日現在単元株以上保有の株主様へ下記のとおり、「ギフトカタログ」をお届けいたします。

- ☐ 100株以上500株未満保有の株主様
5,000円相当のギフトカタログ
- ☐ 500株以上1,000株未満保有の株主様
10,000円相当のギフトカタログ
- ☐ 1,000株以上保有の株主様
15,000円相当のギフトカタログ



100株以上500株未満
5,000円相当の品



500株以上1,000株未満
10,000円相当の品



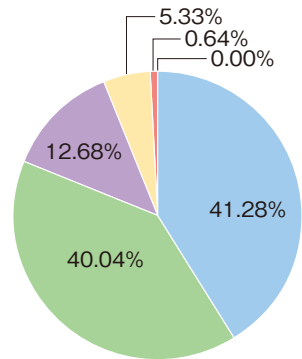
1,000株以上
15,000円相当の品

● 株式の状況

発行済株式総数 3,527,400株
株主数 5,836名

● 所有者別株式分布状況

個人・その他 1,456,323株 41.28%
その他国内法人 1,412,400株 40.04%
金融機関 447,600株 12.68%
外国人等 188,331株 5.33%
証券会社 22,627株 0.64%
自己名義株式 119株 0.00%



● 大株主の状況

株主名	持株数(株)	出資比率(%)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	196,600	5.57
粕谷佳允	170,300	4.82
日本パーライジング株式会社	113,500	3.21
日本高純度化学株式会社	110,000	3.11
荏原実業株式会社	100,000	2.83
株式会社S・D・PA	100,000	2.83
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	94,900	2.69
日本化学産業株式会社	93,000	2.63
神谷理研株式会社	80,000	2.26
栄電子工業株式会社	80,000	2.26
株式会社ユニゾーン	80,000	2.26

(注) 出資比率は自己株式(119株)を控除して計算してあります。

- 商 号 荏原ユーージャイト株式会社
- 本社所在地 東京都台東区台東四丁目19番9号 山口ビル7
- 設 立 1968年(昭和43年)4月1日
- 資 本 金 1,176,255,128円
- 事 業 所 【国内】
大阪支店 名古屋支店 高崎支店 浜松営業所
九州営業所 総合研究所 新潟工場
【連結子会社】
・荏原ユーージャイト(上海)貿易有限公司
広州分公司
・荏原ユーージャイト貿易(深圳)有限公司
蘇州事務所
・台湾荏原ユーージャイト股份有限公司
・EBARA-UDYLITE (KOREA) CO., LTD.
・EBARA-UDYLITE (ASIA-PACIFIC) CO., LTD.
・EBARA-UDYLITE AMERICA, S.A.DE C.V.
・EBARA-UDYLITE VIETNAM CO., LTD.
・銀座鈴蘭堂化粧品股份有限公司(台湾)
【関連会社】
・PROGRESSIVE EU CHEMICALS PVT. LTD.
・JCU Nanomate 株式会社
・深圳森荏真空镀膜有限公司

- 役 員 一 覧 (2011年6月29日)
代表取締役会長兼CEO 粕谷 佳允
代表取締役社長兼COO 小澤 惠二
専務取締役専務執行役員 大木 繁司
専務取締役専務執行役員 上谷 正明
専務取締役専務執行役員 君塚 亮一
常務取締役常務執行役員 中澤 隆司
常務取締役常務執行役員 山本 雅司
常務取締役常務執行役員 中村 憲二
取締役常務執行役員 木村 隆男
執行役員 福島 敏明
執行役員 小林 幹司
執行役員 戸田 久之
常勤監査役 大野 寛二
社外監査役 伴 峰夫
社外監査役 岸 富也
社外監査役 高中 正彦

- 従 業 員 数 連結 361名(51名) 単体 254名(14名)

(注) 臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます)は、年間の平均人員を()外数で記載しております。